

10月31日(金) 12:35-14:50

セッションチェアマン： 平澤 拓(パナソニック ホールディングス㈱)・泉谷 淳子(㈱村田製作所)

◆ データセンターの放熱/冷却技術の最新動向(仮題)



株式会社サーマルデザインラボ

國峯 直樹

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 半導体パッケージの熱シミュレーションモデルの国際規格(仮題)



パナソニックインダストリー株式会社

熊野 豊

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 薄型ペーパーチャンバーの性能向上に向けた設計について(仮題)



株式会社村田製作所

王山 孟明

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【A-1】ロボティクス

【A-3】光通信技術・応用